

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于 2025 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更加全面深入了解产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营成果、财务状况，公司于 2026 年 7 月 1 日（星期三）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动形式召开了 2025 年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2026 年 6 月 24 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了临 2026-036 号《三佳科技关于召开 2025 年度业绩说明会的预告公告》。2026 年 7 月 1 日上午，公司董事长裴晓辉先生，副董事长、总经理昌望先生，财务总监汪兵先生，独立董事黄顺武先生，董事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2025 年度经营成果、财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会，公司就本次会上投资者提出的问题及预征集的问题给予了回答。现将本次业绩说明会提出的主要问题及回复情况整理如下：

1. **投资者提问：**公司 2026 年中报扣非净利润是否能大于 650 万？公司上半年陆续参加了半导体展览，签订的订单是否体现在中报还是三季度报中？

回复：公司 2026 年半年度经营业绩受订单交付时间、验收进度、原材料价格等多重因素综合影响，半年度扣非净利润具体数据请以公司后续正式披露的 2026 年半年度报告为准，公司预约的 2026 年半年度报告披露时间为 2026 年 8 月 27 日。

2. 投资者提问：在 6.15 号机构调研中回复过公司研究院后续计划整体搬迁至合肥，预计什么时候完成？后续是否围绕合肥半导体或者芯片公司扩大相应的合作？公司打造三佳科技为百亿市值公司，是否有什么措施？公司定增预计什么时候完成？

回复：研究院整体搬迁至合肥正在按规划稳步推进。公司将继续聚焦主业，持续技术创新、拓展优质客户、优化经营质量、提升营收利润规模，同时规范公司治理、做好投资者沟通、传递企业成长价值，以稳健经营推动公司长期价值提升。公司将依规稳步推进再融资各项工作。

3. 投资者提问：请问公司如何看待当前半导体封装装备行业的市场竞争格局？公司在技术壁垒和市场份额方面有哪些具体优势？

回复：目前半导体封装装备市场的国内国产化替代持续推进，行业竞争逐步从低端价格竞争转向技术、方案与可靠性综合竞争。公司核心优势在于具备自研能力、工艺协同性及适配性，与下游头部客户长期合作，深度绑定国内主流封测企业，后续将持续攻坚先进封装设备研发，稳步提升国产化市场份额。

4. 投资者提问：公司核心主业的盈利趋势如何？对未来盈利能力有何预期？

回复：公司经过多年发展，核心业务涵盖半导体封装装备及智能制造业务两大板块，公司核心业务经营基本面稳步增长。目前整个行业市场景气度向好，基于当前良好的行业态势及公司订单储备情况，公司对顺利达成本年度订单经营目标具有信心。公司将继续聚焦主业、降本增效、拓展优质订单，多措并举夯实盈利基础，力争经营效益稳步提升。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年七月二日